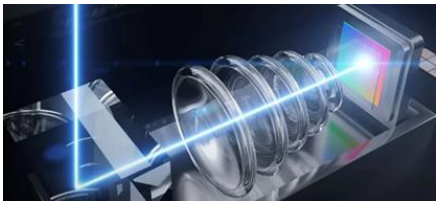
低反発カバーレイ
『C90タイプ』

使用例

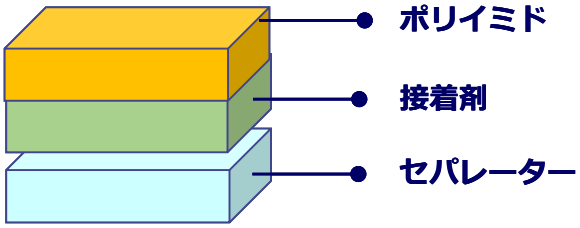
・スマートフォン
・タブレット
・デジタルカメラ



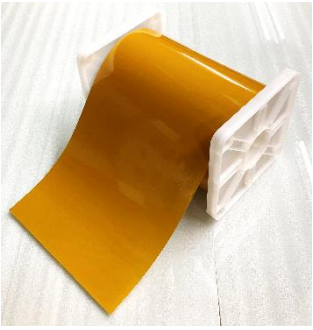
特徴

・低反発性且つ、形状保持性により、折り曲げ組み込みが可能です。
・ファイン回路(L/S=20/20)向けの高絶縁カバーレイです。

構成



■製品外観



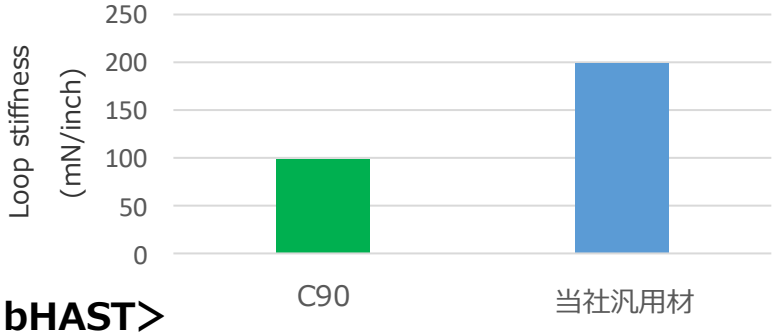
特性

<特性表>

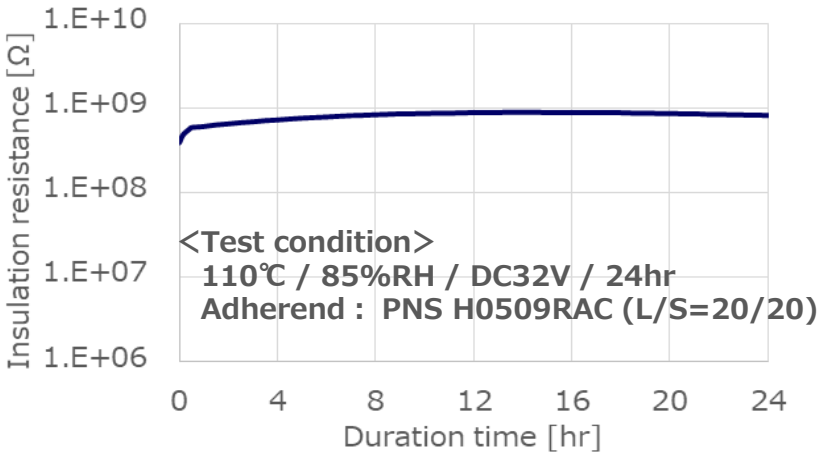
項目	単位	C90
引きはがし強さ (90°Cu引き)	N/cm	8
はんだ耐熱性	℃	300
難燃性	–	V-0 相当
接着剤　Tg	℃	61
接着剤　弾性率	GPa	0.4

プレス条件：160℃×3MPa×60min

<反発力試験>



<bHAST>



ARISAWA
お問合せ先　東京本社　東京都台東区柳橋2丁目12番5号　Tel：03-3861-1110
関西営業所　大阪市西成区津守3丁目7番27号　Tel：06-4703-3168

本カタログに掲載されている特性データなどは当社の測定したデータであり、お客様のご使用時の製品特性を保証するものではありません。
Copyright©2011 Arisawa Manufacturing Co., Ltd. All Rights Reserved.